

Bergquist贝格斯Gap Pad HC3.0导热材料GPHC3.0导热硅胶片

产品名称	Bergquist贝格斯Gap Pad HC3.0导热材料GPHC3.0导热硅胶片
公司名称	广州锐旭科技有限公司
价格	230.00/张
规格参数	品牌:贝格斯 型号:GapPad HC3.0 产地:美国
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-E2433(仅限办公用途)(JM)
联系电话	020-36966020 18927581781

产品详情

名称:美国贝格斯 Gap Pad HC 3.0

厚度(Thickness) : 0.25mm 0.51mm 1.02mm 1.52mm 2.03mm 2.54mm 3.18mm

片材(Sheet) : 203 mm *406 mm

卷材(Roll) : 无

导热系数(Thermal Conductivity) : 3.0W/m-k

基材(Reinforcement Carrier) : 玻璃纤维

胶面(Glue) : 无

颜色(Color) : 蓝色

包装(Pack) : 美国原装进口包装

抗击穿电压(Dielectric Breakdown Voltage) (Vac) : > 5000

持续使用温度 (Continuous Use Temp) : -60 ° ~200 °

Gap PadHC3.0应用材料特性：

Gap PadHC3.0在非常低的压力下，低的S系列热阻，高的贴服性，S系列软度。针对低应力应用设计玻纤增强，提高加工性能和搞斯裂性

Gap PadHC3.0材料应用：

处理器，服务器S-RAMS,大容量存储驱动器，有线/无线通讯硬件，笔记本电脑，BGA封装，功率转换器

Gap PadHC3.0技术优势分析：

Gap PadHC3.0导热界面材料系列以更好的贴服性，更高的导热性能及易于应用来满足电子工业对导热界面材料的日益增长的需要；在凹凸不平的表面，空气间隙和表面粗糙的散热器与电子元器件之间，广泛的Gap PadHC3.0提供一个有效的导热界面。